

財團法人工業技術研究院 函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：李怡秋
電話：03-5917759
傳真：03-5910466
E-mail：Lislee@itri.org.tw



1110011049006

106 台北市大安區復興南路一段 390 號 9 樓

受文者：台灣區車輛工業同業公會

發文日期：中華民國 111 年 06 月 09 日

發文字號：工研轉字第 1110011049 號

速別：普通件

密等：無

附件：如文

主旨：本院擬舉辦「111 年度工研院材料與化工研究所 5G 高頻通訊基板相關材料等相關研發成果非專屬授權案」之公開說明會，請轉知貴會會員等相關廠商把握機會參與本次推廣活動，請查照。

說明：

- 一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，本院將舉辦 5G 高頻通訊基板相關材料等相關研發成果非專屬授權案(共計 25 案 72 件申請中、獲證專利)之公開說明會(授權標的詳如附件)。
- 二、專利「授權標的」共分為七個類別，包含(一) 5G 半導體/LTCC 元件材(2 案 5 件)、(二) 高頻銅箔(5 案 12 件)、(三) 5G EMI 複材及量測技術(3 案 7 件)、(四) 5G 高頻 MIP 軟板材料(5 案 14 件)、(五) 5G 高頻 LCP 軟板材料(1 案 10 件)、(六) 5G 高頻樹脂材料(4 案 10 件)及(七) 5G 低介電低耗損絕緣/增層/封裝材(5 案 14 件)。
- 三、有關本活動詳細資訊，請參考工研院研發成果公告網站(https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=01_content&SiteID=1&MmmID=1036461244216621372&MGID=1)

111. 6. 10

車輛公會
收文總號

302

162612176720265161)。

四、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

五、公開說明會：

(一) 舉辦時間：民國(下同)111年6月30日15時。

(二) 舉辦地點：採線上公開說明會。

(三) 報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於111年6月29日12時整(含)前以電子郵件向本案聯絡人報名(主旨請註明「111年度工研院材料與化工研究所5G高頻通訊基板相關材料等相關研發成果非專屬授權案：公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱)。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於111年6月29日17時整(含)前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

六、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 李小姐

電話：(03) 591-7759

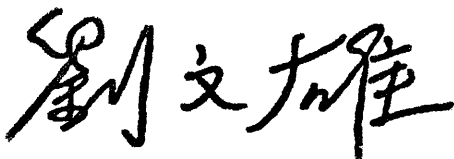
傳真：(03) 582-0466

電子信箱：lislee@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館110室

正本受文者：台灣區車輛工業同業公會

院長



依權責劃分規定授權業務主管執行

111 年度工研院材料與化工研究所

5G 高頻通訊基板相關材料等相關研發成果非專屬授權案

- 一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）
- 二、非專屬授權標的：5G 高頻通訊基板相關材料等相關研發成果，共計 25 案 72 件獲證及申請中專利。詳細資訊請參「附件：授權標的清單」。
- 三、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。
- 四、公開說明會：
 - （一）舉辦時間：民國（下同）111 年 6 月 30 日 15 時。
 - （二）舉辦地點：線上公開說明會。
 - （三）報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 111 年 6 月 29 日 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「111 年度工研院材料與化工研究所 5G 高頻通訊基板相關材料等相關研發成果非專屬授權案公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 111 年 6 月 29 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
- 五、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 李小姐
電話：03-5917759
傳真：03-5820466
電子信箱：lislee@itri.org.tw
地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件：授權標的清單

案號	案號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	授權紀錄	
5G 半導體 /LTCC 元 件材	1	P54080 040TW	碳化矽粉體的純化方法	中華民國	獲證	108140793	I698397	20200711	20391110	經濟部 技術處		
		P54080 040US	碳化矽粉體的純化方法	美國	獲證	16/729,065	11046582	20210629	20400402	經濟部 技術處		
	2	P54080 070JP	低介電材料與其形成方法	日本	審查中	2020-214024					經濟部 技術處	
		P54080 070TW C1	低介電材料與其形成方法	中華民國	審查中	109145693					經濟部 技術處	
		P54080 070US	低介電材料與其形成方法	美國	審查中	17/133,270					經濟部 技術處	
	高頻銅箔	3	P54050 059CN	銅箔複材	中國大陸	獲證	201611257153. X	CN108267 870	20210330	20361229	經濟部 技術處	
P54050 059TW			銅箔複材	中華民國	獲證	105144023	I607866	20171211	20361229	經濟部 技術處		
4		P54060 022CN	底漆組成物與使用該底漆組成物的銅箔基板	中國大陸	獲證	201810552437.4	CN109385 174	20210427	20380530	經濟部 技術處		
		P54060 022TW	底漆組成物與使用該底漆組成物之銅箔基板	中華民國	獲證	107113094	I702264	20200821	20380416	經濟部 技術處		
		P54060 022US	底漆組成物與使用該底漆組成物之銅箔基板	美國	獲證	16/057,779	10917964	20210209	20390101	經濟部 技術處		
5		P54060 023US D1	高頻電路用銅箔及其製造方法	美國	審查中	16/917,914				經濟部 技術處		
6		P54080 080CN	底漆組合物及積層板	中國大陸	審查中	202010493214.2					經濟部 技術處	
		P54080 080TW	底漆組合物及積層板	中華民國	獲證	108148599	I731537	20210621	20391230	經濟部 技術處		
		P54080 080US	底漆組合物及積層板	美國	審查中	16/919,619					經濟部 技術處	
7		P54060 043CN	基板組合物及由其所製備的基板	中國大陸	獲證	201810825043.1	CN109912 908	20210518	20380724	經濟部 技術處	v	
		P54060 043TW C1	基板組成物及由其所製備之基板	中華民國	獲證	107121300	I695033	20200601	20380620	經濟部 技術處	v	
		P54060 043US	基板組成物及由其所製備之基板	美國	獲證	16/116,706	10640637	20200505	20380914	經濟部 技術處	v	

案號	案號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	授權紀錄	
5G EMI 複材及量測技術	8	P54100079TW	電磁波吸收材及用於抑制電磁干擾的複合結構	中華民國	審查中	110149762				經濟部技術處		
		9	P54080077CN	電磁特性量測裝置與系統以及電磁特性量測方法	中國大陸	審查中	202011505966.2				經濟部技術處	
	P54080077JP		電磁特性量測裝置、電磁特性量測系統以及電磁特性量測方法	日本	審查中	2020-210577				經濟部技術處		
	P54080077TW		電磁特性量測裝置、電磁特性量測系統以及電磁特性量測方法	中華民國	審查中	109144906				經濟部技術處		
	P54080077US		電磁特性量測裝置、電磁特性量測系統以及電磁特性量測方法	美國	審查中	17/126,025				經濟部技術處		
	10		P54010072CN	屏蔽複合膜片	中國大陸	獲證	201210579784.9	CN103889197	20161228	20321226	經濟部技術處	
		P54010072TW	屏蔽複合膜片	中華民國	獲證	101149188	I482585	20150421	20321220	經濟部技術處		
	5G 高頻 MPI 軟板材料	11	P54090034US	化合物、樹脂組合物、及積層板	美國	審查中	17/138,254				經濟部技術處	
			P54090034TW	化合物、樹脂組合物、及積層板	中華民國	審查中	110116722				經濟部技術處	
			P54090034CN	聚醯亞胺樹脂前驅物及其應用	中國大陸	審查中	202110435689.0				經濟部技術處	
12		P54060037CN	感光型複合材料及使用其形成複合薄膜的方法	中國大陸	審查中	201811511723.2					經濟部技術處	
		P54060037TW C1	感光型複合材料及使用其形成複合薄膜之方法	中華民國	獲證	107137184	I691535	20200421	20381021	經濟部技術處		
		P54060037US	感光型複合材料及使用其形成複合薄膜之方法	美國	獲證	16/226,147	11106134	20210831	20390414	經濟部技術處		
13		P54100008CN	聚醯亞胺、薄膜組合物及其所形成之薄膜	中國大陸	審查中	202111612689.X					經濟部技術處	
		P54100008JP	聚醯亞胺、薄膜組合物及其所形成之薄膜	日本	審查中	2021-214037					經濟部技術處	
		P54100008TW	聚醯亞胺、薄膜組合物及其所形成之薄膜	中華民國	審查中	110145399					經濟部技術處	
		P54100008US	聚醯亞胺、薄膜組合物及其所形成之薄膜	美國	審查中	17/564,997					經濟部技術處	

案號	案號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	授權紀錄
	14	P54110 005CN	感光組合物及其所形成的薄膜	中國大陸	審查中	202210306158.6				經濟部技術處	
		P54110 005TW	感光組合物及其所形成之薄膜	中華民國	審查中	111111400				經濟部技術處	
	15	P54100 021CN	酸酐化合物、由其製得的聚醯亞胺與薄膜	中國大陸	審查中	202210253455.9				經濟部技術處	
		P54100 021TW	酸酐化合物、聚醯亞胺、與薄膜	中華民國	審查中	110145616				經濟部技術處	
5G 高頻 LCP 軟板 材料	16	P54080 018CN	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液與液晶聚合物薄膜的形成方法	中國大陸	審查中	202010585756.2				經濟部技術處	v
		P54080 018CN A1	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液與液晶聚合物薄膜的形成方法	中國大陸	審查中	202010615947.9				經濟部技術處	v
		P54080 018EP	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液、與液晶聚合物薄膜的形成方法	EPC/ 歐盟	審查中	20182251.7				經濟部技術處	
		P54080 018EP A1	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液、與液晶聚合物薄膜的形成方法	EPC/ 歐盟	審查中	20183612.9				經濟部技術處	
		P54080 018JP	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液、與液晶聚合物薄膜的形成方法	日本	審查中	2020-113162				經濟部技術處	
		P54080 018JPA 1	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液、與液晶聚合物薄膜的形成方法	日本	審查中	2020-113762				經濟部技術處	
		P54080 018TW	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液、與液晶聚合物薄膜的形成方法	中華民國	審查中	109112311				經濟部技術處	v
		P54080 018TW A1	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液、與液晶聚合物薄膜的形成方法	中華民國	獲證	109121301	I727835	20210511	20400622	經濟部技術處	v

案號	案號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	授權紀錄
		P54080 018US	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液、與液晶聚合物薄膜的形成方法	美國	審查中	16/918,551				經濟部 技術處	
		P54080 018US A1	液晶聚合物、積層材料、液晶聚合物溶液、與液晶聚合物薄膜的形成方法	美國	審查中	16/918,990				經濟部 技術處	
	17	P54070 021US	薄膜組成物及其所形成之薄膜	美國	獲證	16/593,320	11059938	20210713	20400311	經濟部 技術處	
	18	P54050 011CN	寡聚物、包含其的組合物及複合材料	中國大陸	獲證	201611270235.8	CN107417 862	20190823	20361229	經濟部 技術處	
P54050 011TW		寡聚物、包含其之組成物及複合材料	中華民國	獲證	105144141	I606076	20171121	20361229	經濟部 技術處		
P54050 011US		寡聚物、包含其之組成物及複合材料	美國	獲證	15/395,599	10179833	20190115	20370811	經濟部 技術處		
5G 高頻樹脂材料	19	P54050 044CN C1	寡聚物、包含其的組合物及複合材料	中國大陸	獲證	201711391873. X	CN108250 720	20210323	20371220	經濟部 技術處	v
		P54050 044TW C1	寡聚物、包含其之組成物及複合材料	中華民國	獲證	106145046	I676641	20191111	20371220	經濟部 技術處	v
		P54050 044US C1	寡聚物、包含其之組成物及複合材料	美國	獲證	15/851,309	10844164	20201124	20370309	經濟部 技術處	v
	20	P54040 086CN	聚苯醚寡聚物及高頻銅箔基板	中國大陸	獲證	201611192062.2	CN107022 075	20190628	20361220	經濟部 技術處	
P54040 086TW		聚苯醚寡聚物及高頻銅箔基板	中華民國	獲證	105142422	I621679	20180421	20361220	經濟部 技術處		
P54040 086US		聚苯醚寡聚物及高頻銅箔基板	美國	獲證	15/386,669	10358585	20190723	20371225	經濟部 技術處		
5G 低介電 低耗損絕 緣/增層/封 裝材	21	P54090 041CN	共聚物與複合材料	中國大陸	審查中	202110695971.2				經濟部 技術處	
		P54090 041TW	共聚物與複合材料	中華民國	審查中	110116352				經濟部 技術處	
		P54090 041US	共聚物與複合材料	美國	審查中	17/497,673				經濟部 技術處	
	22	P54100 033CN	樹脂化合物以及包含其的樹脂組合物	中國大陸	審查中	202210155445				經濟部 技術處	

案號	案號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	授權紀錄	
		P54100 033TW	樹脂化合物以及包含其 之樹脂組合物	中華民國	審查中	110145160				經濟部 技術處		
		P54100 033US	樹脂化合物以及包含其 之樹脂組合物	美國	審查中	17/590,530				經濟部 技術處		
	23	P54060 086CN	組成物、包含其之絕緣 材料及其製法	中國大陸	審查中	201811598548.5					經濟部 技術處	
		P54060 086TW	組成物、包含其之絕緣 材料及其製法	中華民國	獲證	107147192	I683852	20200201	20381225	經濟部 技術處		
		P54060 086US	組成物、包含其之絕緣 材料及其製法	美國	獲證	16/232,766	11118082	20210914	20390807	經濟部 技術處		
	24	P54100 074CN	共聚物、樹脂、與複合 材料	中國大陸	審查中	202210146890.1					經濟部 技術處	
		P54100 074TW	共聚物、樹脂、與複合 材料	中華民國	審查中	110149262					經濟部 技術處	
	25	P54090 035CN	聚合物及包含其之樹脂 組合物	中國大陸	審查中	202110436167.2					經濟部 技術處	
		P54090 035TW	聚合物及包含其之樹脂 組合物	中華民國	審查中	110103657					經濟部 技術處	v
P54090 035US		聚合物及包含其之樹脂 組合物	美國	審查中	17/139,088					經濟部 技術處	v	

【備註】：本授權案公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。